

IEC/TC40(電子機器用コンデンサ及び抵抗器)デルフト会議の報告

IEC/TC40デルフト会議の報告
11ヶ国から35名が参加

IEC/TC40の概要

TC40（電子機器用コンデンサ及び抵抗器）は、TC40で作成する規格の整合化のため、サブコミティ(SC)を設置せず、一つの技術委員会(TC)で審議する形をとっています。その組織体系及び規格体系は、下記のとおりです。

デルフト会議の概要

TC40会議は、2002年のベルリン会議以来の3年振りで、TC40/WG36会議は、2年振りの会議となりました。今回の会議は、オランダのデルフト市にて2005年5月10日から12日までの3日間、4つのメインテナンスチーム(MT)会議、1つのワーキンググループ(WG36)会議

及び二つ(Part C & Filter及びPart G & R)の部門会議が開催されました。この会議には、日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、イタリア、オランダ、韓国など11ヶ国、35名が参加しました。

日本からは、村田製作所、日本ケミコン、KOA、アルプス電気、ニチコン、太陽誘電、ルビコン、パナソニックエレクトロニックデバイス、松下電器産業、信越ポリマー、JEITA事務局から、11名が参加しました。

すべての会議の議題は、日本からの改正・修正提案、新規業務の紹介などが占めました。

(1) TC40 Plenary Part C & Filter会議

日本からの新規提案(7規格)について、プロジェクトリーダー(いずれも日本)から、プロジェクト内の審議・進捗報告があり、次の段階に進むことが承認されました(アルミニウム導電性固体電解コンデンサ2件及びタンタル導電性固体電解コンデンサ2件：CDV段階

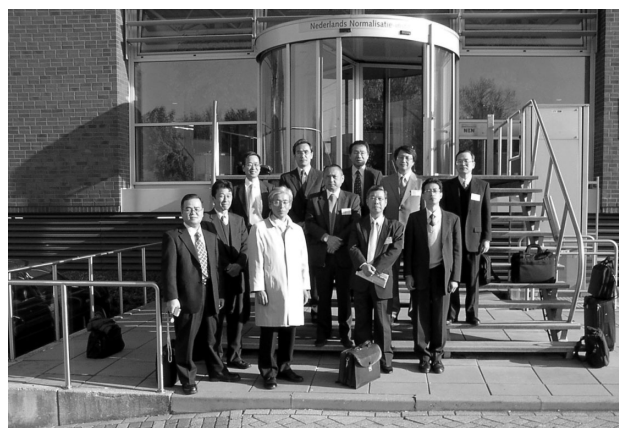
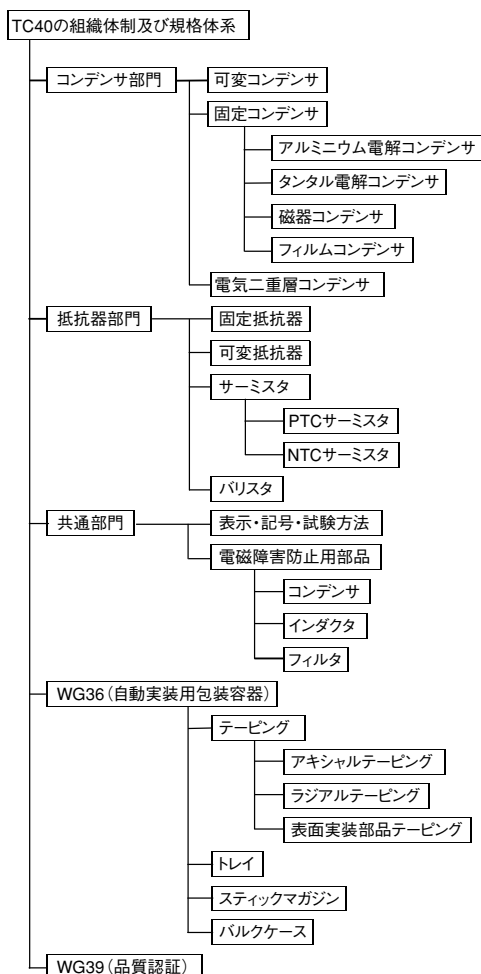


写真1. 日本からの参加者(オランダ工業会前にて)



写真2. IEC/TC40 Plenary Part C&Filterの会議風景

へ、電気二重層コンデンサ3件：FDIS段階へ)。

事前に開催された電解コンデンサ（アルミニウム及びタンタル）の各MT会議において、日本から、技術の発展に伴う実体に即した部品特性の在り方及びその規定値のあり方について提案があり、承認されました。これは、その後のPlenary会議でも承認されました。

コンデンサの低インダクタンス測定方法について、日本から紹介しました。これは、1年以内に新規提案することとなりました。

各受動部品（8件）の安全アプリケーションガイドを日本から紹介しました。しかし、IECの技術報告書としてまとまった場合に、IECという大幅な認知度の確保に反して、顧客への展開が自由にできない著作権の問題が顕在化しました。同様な試みは、欧州でも以前に行われたが著作権の問題があって途中で断念したとの報告があり、日本からの正式提案は保留とされました。ただし、回覧した磁器コンデンサの文書が高く評価され、技術資料としての提示を一部委員から求められました。これは、参考送付することとし、英文を含めた確認を頂けることとなりました。

(2) TC40 Plenary Part G & R会議

既存の規格に規定されているIECQ制度を念頭に置いた品質認証の事項について、その在り方について提案がありました。この内容は、IECQ制度を重視する欧州から継続検討の提案があるため、専門家によるWG39を設置して検討することとなりました。

固定抵抗器の規格改定において、自動車用などの厳しい用途に対応したプロフェッショナル仕様を設け、



写真3. IEC/TC40 Plenary Part G&Rの会議風景

IECQ認証の一助にするという提案と、この考え方を他の部品にも広げたいとの提案が欧州からありました。この内容は、何を以ってプロフェッショナルとするかの定義を含め、継続して検討することとなりました。また、部品本体にTC101に規定の試験方法に基づき、静電気を印加する提案に対して、自動車メーカーからの要求があることから、この静電気提案も継続検討となりました。

可変抵抗器に関する改正の変更点のポイントを、日本から紹介しました。

TC40文書がTC108文書の中で正確にその規定内容が引用されていないことがクローズアップされ、関係者間で連携の上、TC108へ提案活動することとなりました。

(3) TC40/WG36会議

極小部品の表面実装部品のテーピングに関連して、プレスキャリアテーピング及びテープ幅=4mm、製品間ピッチ=1mmのエンボスキャリアについて、日本から紹介しました。これは、1年以内に新規提案を行うこととなりました。

現行の表面実装部品テーピングの改正審議の中で、カバーテープの貼付け位置は両端だけでなく、小形・薄形部品のためポケット間にも認められました。カバーテープのはく離強度は、現行のままとなりました。

半導体用トレイの外形に反りなどの変形が発生して問題となるとして、日本からその測定方法を紹介しました。1年以内に新規提案を行うこととなりました。

■ デルフト会議の成果と課題

今回は、日本からの提案・紹介が殆どであり、また関係者による資料の準備が整っていたこともあり、日本からの殆どの提案が承認されました。ただし、その多くを1年以内に新規業務提案（NP）することになったため、これらの提案の進捗状況をフォローする必要があります。

次回は、韓国から招致提案があり、2006年5月31日から6月2日に、ソウルで開催される予定となりました。今回と同様に万全の対応を取れるように、関係者の力を結集して準備していきたいと思っております。